



Research and
Development Center

景气周期+成长主线，

持续看好半导体板块行情

电子行业周报

2021年7月12日

证券研究报告

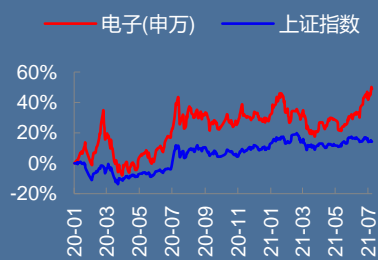
行业研究

行业周报

电子

投资评级 看好

上次评级 看好



数据来源：万得，信达证券研发中心

方 竞 电子行业首席分析师

执业编号：S1500520030001

邮 箱：fangjing@cindasc.com

李 少 青 电子行业分析师

执业编号：S1500520080004

邮 箱：lishaoqing@cindasc.com

刘 志 来 研究助理

邮 箱：liuzhilai@cindasc.com

童 秋 涛 研究助理

邮 箱：tongqiutao@cindasc.com

信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO., LTD

北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

邮编：100031

景气周期+成长主线，持续看好半导体板块行情

2021年7月12日

本期内容提要：

- **本周电子板块依旧强势：**本周电子板块上涨 5.0%，跑赢沪深 300 指数 5.2 个百分点，中报业绩牛正持续兑现。就细分板块来看，我们自去年以来持续强调看好半导体景气周期，当前缺货涨价仍在持续。大众汽车表示下半年全球汽车半导体紧缺将进一步恶化。在此趋势下，**我们持续看好具备产能优势的 IDM 厂商及晶圆厂；此外晶丰明源等优秀模拟公司，在品类扩张及涨价驱动下，全年业绩弹性同样凸显。**

综合来看，板块公司业绩弹性与下游客户集中度、议价能力等因素息息相关。下游市场越分散，涨价驱动力越强，有助产业链公司业绩释放，增厚利润。不过，涨价也要视下游承受能力而定，近期 LED 显示屏厂蓝普视讯宣布将对恶意不执行合同的芯片供应商发起集体诉讼。这也是对行业的警醒，无序的涨价会无形中削弱公司的客户基础。而部分优质公司由于切入大客户，涨价幅度有限，短跑弱于其他厂商，但有助长线竞争力。

- **除景气周期外，建议关注三大成长主线：汽车电子，IOT 及半导体设备。**
 - 1) 汽车电子：**当前新能源汽车正处于快速渗透期，根据乘联会数据，6 月份国内新能源乘用车销量 23.0 万辆，同比增长 177.7%，占到国内乘用车销量的 14.6%。电动化趋势下，汽车功率器件需求量大幅增长。同时汽车亦将持续推进智能化升级，高级辅助驾驶、车载娱乐系统的功能愈发强大，带动车载存储需求量提升。**建议关注 IGBT 核心标的斯达半导、中车时代电气、士兰微；车载存储龙头北京君正。**

2) IoT：本周，国际物联网传感技术峰会上，工信部表示正制定物联网新基建三年行动计划，加速推动 IoT 基础设施建设。**我们继续看好感知、处理、传输、模拟四大方向的芯片厂商投资机遇。**主要标的有：感知芯片，即 MEMS（歌尔微电子、敏芯股份）；处理器芯片（瑞芯微、全志科技、晶晨股份）；传输芯片（乐鑫科技、恒玄科技、博通集成）；模拟芯片（圣邦股份、思瑞浦、芯海科技、钰泰半导体、英集芯）。

3) 半导体设备：设备是半导体行业景气度的二阶导，国产替代需求持续推动本土晶圆厂建设，而缺货潮则加速了这一进程。据集微咨询数据，2021 年国内主要晶圆厂将增加 12 英寸 26.7 万片/月，8 英寸 15.5 万片/月的新建产能。此外设备国产化程度亦逐年提高，据我们统计，2021 年中芯、华虹、长存招标设备国产化率已近三成。**半导体设备龙头业绩弹性可期，建议关注北方华创、中微公司、至纯科技、万业企业等。**

- **投资评级：**我们认为，前期半导体行情主要围绕景气周期展开，诸多涨价标的畅享业绩弹性，当下半导体景气度依旧高企，中报业绩行情仍将持续，**我们持续看好具备产能优势的 IDM 厂商及晶圆厂**，如士兰微、华虹半导体等。此外晶丰明源等优秀模拟公司，在品类扩张及涨价驱动下，全年业绩弹性同样凸显。

中期来看，投资标建议优选具备成长属性的龙头公司。从景气周期向成长周期不断转移。**建议关注三大成长主线：汽车、IOT 及设备。**汽车方面，我们核心推荐标的有：IGBT 龙头斯达半导、中车时代电气、士兰微；车载存储龙头北京君正。**IOT 方面**，我们继续看好感知、处理、传输、模拟四大方向的芯片厂商投资机遇。**设备方面**，建议关注北方华创、中微公司、至纯科技、万业企业等。此外封测设备龙头华峰测控同样长期看好。

- **风险因素：**市场竞争加剧；疫情持续，影响需求；技术渗透不及预期；中美贸易纠纷风险，半导体景气度下行风险。

表 1: 国内主要晶圆厂产能情况 (万片/月)

序号	项目名称	尺寸 (英寸)	地点	现有产能	2021 新增 产能	总目标产能	类型	状态
1	中芯国际 (北京)	12	北京	5	0	5	代工	量产
2	中芯北方	12	北京	5	1	7	代工	量产
3	中芯南方	12	上海	0.6	0	1.4	代工	量产
4	中芯国际 (上海)	12	上海	3.5	0	3.5	代工	量产
5	中芯京城	12	北京	0	0	10	代工	在建
6	中芯国际 (深圳)	12	深圳	0	0	4	代工	在建
7	武汉新芯	12	武汉	2.7	1.3	4.5	代工	量产
8	合肥晶合集成	12	合肥	4	3	10	代工	量产
9		12	合肥	0	0	16	代工	在建
10	广州粤芯	12	广州	1.6	0.4	3.5	代工	量产
11	士兰微厦门	12	厦门	0	3	4	IDM	量产
12	华润微电子	12	重庆	0	0	3	IDM	在建
13	积塔	12	上海	0	0	0.5	代工	在建
14	长江存储	12	武汉	5	5	10	IDM	量产
15		12	武汉	0	0	10	IDM	在建
16		12	武汉	0	0	10	IDM	在建
17	长鑫存储	12	合肥	4.5	7.5	36	IDM	量产
18	紫光国微	12	成都	0	0	30	IDM	在建
19	福建晋华	12	泉州	未知	0	6	IDM	量产
20	华虹无锡	12	无锡	2	4.5	6.5	代工	量产
21	华力微	12	上海	3.5	0	3.5	代工	量产
22		12	上海	2.5	1	4.5	代工	量产
23	杭州积海	12	杭州	0	0	2	代工	在建
24	杭州富芯	12	杭州	0	0	3	IDM	在建
25	上海闻泰	12	上海	0	0	3	IDM	在建
26	上海格科微	12	上海	0	0	2	IDM	在建
27	台积电	12	南京	0	0	2	代工	在建
28	联电	12	厦门	0	0	0.5	代工	在建
29	三星	12	西安	未知	未知	13	IDM	在建
30	海辰半导体	8	无锡			5	IDM	在建
31		8	无锡			6.5	IDM	在建
32	中芯国际 (上海)	8	上海	11.5	0	18	代工	量产
33	中芯国际 (天津)	8	天津	7.3	4.5	15	代工	量产
34	中芯国际 (深圳)	8	深圳	4.6	0	6	代工	量产
35	积塔 (原上海先进)	8	上海	2.8	0	3	代工	量产
36	积塔	8	上海	1	1	10	代工	量产
37	中芯绍兴	8	绍兴	5	4	9	代工	量产
38	中芯宁波	8	宁波	0	0	3	代工	在建
39	士兰微	8	杭州	6.5	0	8	IDM	量产
40	华润微电子	8	重庆	5.7	0.9	6.6	IDM	量产
41		8	无锡	6.4	1.6	8	代工	量产
42	燕东微电子	8	北京	1.5	3.5	5	代工	量产
43	华虹宏力	8	上海	6.5	0	6.5	代工	量产
44		8	上海	5	0	6.5	代工	量产
45		8	上海	7	0	6.5	代工	量产
46	中车时代电气	8	株洲	1	0	3	IDM	量产
47	芯恩	8	青岛	0	0	4	代工	在建
48	济南富元电子	8	济南	0	0	3	IDM	在建
49	中科汉天下	8	杭州	0	0	1	IDM	在建
50	赛微	8	北京	1	0	3	代工	量产
51	中芯宁波	8	宁波	0.2	0	4.25	代工	量产
52	比亚迪长沙	8	长沙	0	0	2	IDM	在建
53	大连宇宙	8	大连	1	0	2	IDM	量产
54	扬州晶新微电子	8	扬州	0	0	5	IDM	在建
产能合计		12 英寸		39.9	26.7	214.4		
		8 英寸		74	15.5	149.85		

资料来源: 集微咨询, 信达证券研究中心

图 1: IoT 芯片核心标的



资料来源: 信达证券研发中心

目录

附录一：上周市场回顾.....	6
附录二：上周科技新闻回顾.....	7
附录三：近期行业数据整理更新.....	10
附录四：上市公司重要公告和未来大事提醒.....	11

表目录

表 1: 国内主要晶圆厂产能情况 (万片/月)	3
表 2: 重要指数和价格变化	6

图目录

图 1: IoT 芯片核心标的	4
图 2: 电子行业子板块周涨跌幅 (%)	6
图 3: 电子行业个股周涨跌幅前五后五 (%)	6
图 4: 48 吋 OLED 电视销量展望 (万台)	10
图 5: 2020 年全球半导体对应下游市场销售额 (亿美元)	10
图 6: 全球 8 吋晶圆厂设备资本支出与预估 (亿美元)	10
图 7: 全球先进、主流、成熟制程已装机晶圆产能比重	10
图 8: 全球 CIS 市场规模及增速 (亿美元)	10
图 9: 2020 年全球 CIS 厂商市占率	10

附录一：上周市场回顾

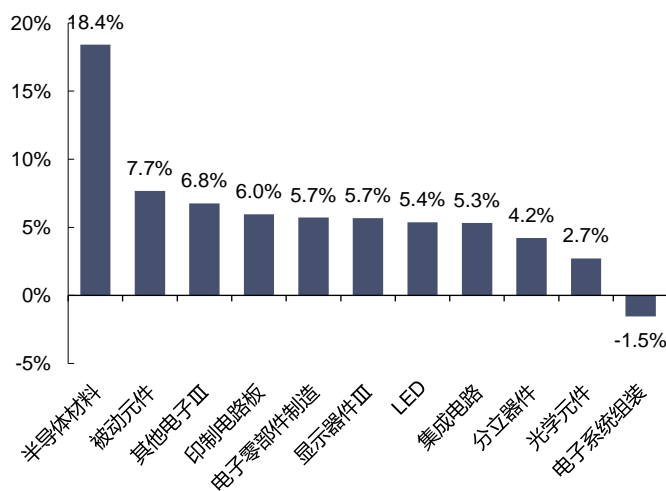
电子板块上周上涨 5.0%，跑赢沪深 300 指数 5.2 个百分点。年初至今电子板块上涨 13.2%，跑赢沪深 300 指数 15.9 个百分点。上周电子行业子板块涨幅分别为半导体材料 18.41%，被动元件 7.66%，其他电子Ⅲ 6.76%，印制电路板 5.95%，电子零部件制造 5.71%，显示器件Ⅲ 5.66%，LED 5.37%，集成电路 5.32%，分立器件 4.21%，光学元件 2.72%，电子系统组装 -1.54%。就个股而言，上周涨幅位于前列的分别是晶丰明源 42.1%，泰晶科技 37.4%，芯源微 35.5%，思瑞浦 28.3%，长川科技 28.0%。

表 2：重要指数和价格变化

全球股指	指数	周度涨跌幅	年初至今涨跌幅	原材料	价格	涨跌幅
沪深 300	5069.4	-0.2%	-2.7%	LME 铝	2494.0	-2.7%
上证综指	3524.1	0.2%	13.9%	LME 铜	9493.0	1.2%
中小板指	9711.1	1.5%	17.3%	DCE 塑料	8280.0	0.6%
创业板指	3409.3	2.3%	14.1%	LME 镍	18755.0	2.3%
道琼斯	34870.2	0.2%	10.2%	LME 锡	31750.0	0.7%
SOX	3278.4	-1.1%	14.4%	LME 锌	2978.0	1.5%
纳斯达克	14701.9	0.4%	17.6%	人民币汇率		
A 股电子	5360.6	5.0%	13.2%	美元	6.476	0.07%
恒生科技	18634.2	-6.5%	-11.3%	欧元	7.668	0.06%
台湾加权	17661.5	-0.3%	19.9%	100 日元	5.897	1.69%
台湾 IT	23424.7	-0.3%	13.1%	美元兑新台币	27.966	0.04%

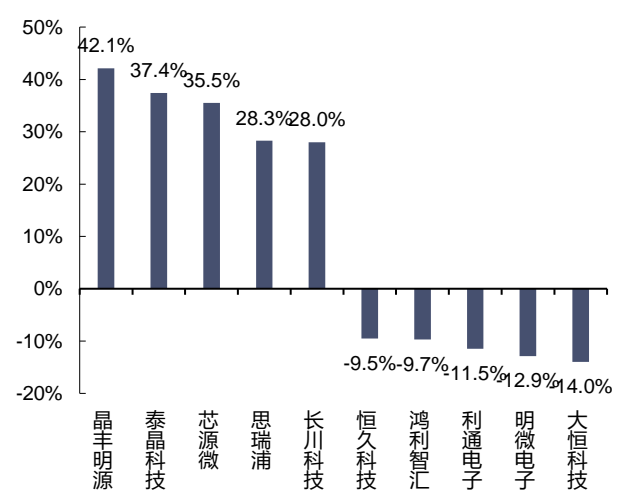
资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 2：电子行业子板块周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 3：电子行业个股周涨跌幅前五后五（%）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

附录二：上周科技新闻回顾

1、消费电子

Counterpoint: 经济下滑带火中低端 TWS 耳机, 2021 年全球市场将增长 33%

尽管 COVID-19 疫情引发经济下滑, 但 2020 年全球 TWS 市场仍同比增长 78%。苹果 2020 年继续领跑市场, 但份额下滑。预计 2021 年第三季度末市场积压的高端 TWS 需求将爆发。(手机技术资讯)

Strategy Analytics: 智能家居行业支出将大幅增长 44%

据 Strategy Analytics 最新报告, 全球智能家居系统支出将在 2021 年反弹, 预计在 2020 年未达到 1000 亿美元大关后, 支出将同比增长 44%, 达到 1230 亿美元。(爱集微)

OLED 笔记本电脑和平板市场增长加速

根据市调机构 Omdia 数据, OLED 笔记本电脑市场的规模预计将从 2019 年的 15 万台增长到今年的 148 万台, 到 2022 年将达到 257 万台。尽管目前这类产品的市场份额不到 1%, 但预计今年和明年的份额将大幅上升。(爱集微)

研究机构: 全球智能音箱市场在未来五年将大幅增长

根据研究机构 Counterpoint 分析报告, 未来几年全球智能音箱出货量将大幅提升, 预计 2020 年到 2025 年, 该市场将以 21% 的复合年增长率增长。(爱集微)

2、半导体

SIA: 全球半导体五月销售额 436 亿美元, 创单月历史新高

7 月 7 日, 美国半导体行业协会(SIA)宣布, 2021 年 5 月, 全球半导体行业销售额为 436 亿美元, 比 2020 年 5 月的 346 亿美元增长 26.2%, 比 4 月份增长 4.1%。2021 年四月的销售总额为 419 亿美元。(爱集微)

中芯国际又一重要项目量产: 月产能 7 万片晶圆、良率 99%

位于绍兴的中芯绍兴开始产能爬坡到 7 万片晶圆/月, 而且量产达到 99%。2020 年是绍兴集成电路产业平台开启全面建设的关键之年。中芯绍兴项目首期总投资 58.8 亿元, 引进一条芯片年出货 51 万片的 8 英寸特色工艺集成电路制造生产线和一条模组年出货 19.95 亿颗的封装测试生产线。(闪信息)

中芯国际: 芯片制造供不应求, 拟扩建 12 英寸和 8 英寸晶圆的产能

7 月 7 日, 中芯国际在互动平台表示, 目前集成电路芯片制造供不应求。公司 2021 年一季度整体产能利用率达到 98.7%。根据公司今年的 CAPEX 支出计划, 拟扩建 1 万片 12 英寸和 4.5 万片 8 英寸晶圆的产能, 以满足更多的客户需求。(爱集微)

闻泰科技全资子公司安世半导体收购 Newport Wafer Fab

闻泰科技称, 公司全资子公司安世半导体(Nexperia)与 Neptune 6 及其股东签署了有关收购协议。本次交易完成

后，公司将间接持有 Newport Wafer Fab (NWF) 100%权益。NWF 为汽车行业生产用于电源应用的硅芯片，该行业受到芯片短缺的打击尤为严重。（闪信息）

传联电和力积电下半年将继续提高晶圆报价 毛利率攀升

消息人士称，联电和力积电将在今年下半年继续提高晶圆报价，看涨的晶圆平均售价将提高两家公司全年的毛利率。联电和力积电将在 2021 年下半年实现利润大幅增长，利润增长势头可能会持续到 2023 年。（闪信息）

供应链：台积电订单饱和至 2024 年，美国延揽目的不在技术

中国台湾地区最大半导体设备代理商、崇越集团董事长郭智辉在指出，就其个人了解，台积电订单几乎满到 2024 年。他进一步指出，美国政府大力招揽台积电赴美设厂，是因为在地缘因素下，台积电一路发展逐渐在本地形成半导体供应链。（闪信息）

联电：半导体结构问题短期难解 产能供不应求或到 2023 年

联电认为，市场需求成长幅度远大于产能增加的速度，这个结构性问题难以在短期获得解决，半导体产能供不应求情况可能会延续到 2023 年。据台媒经济日报报道，联电今天召开股东常会，联电共同总经理简山杰表示，疫情冲击全球经济，半导体市场却因为疫情带动数字化转型加速，反而大幅成长，半导体产能全面供不应求，8 英寸厂和 12 英寸厂及成熟制程产能紧张情况更为严重。（闪信息）

南亚科第二季营收 创 11 季新高

记忆体厂南亚科受惠于 DRAM 供不应求且价格大涨，5 日公告第二季合并营收 226.37 亿元，创下 11 季度以来新高。法人看好南亚科出货均价涨幅扩大情况下，第二季毛利率将大幅回升至 40% 以上，单季获利可望较上季倍增。由于业界普遍看好 DRAM 价格逐季调涨到年底，南亚科直接受惠，下半年营收及获利逐季成长态势明确。（中时电子报）

3、汽车电子

车用“缺芯”Q3 或缓和，2022 年 Q1 恢复正常

随着各大车用芯片厂出货量恢复到正常水准，市场研究公司 IHS Markit 在日前的报告预测，自从去年底开始的汽车芯片短缺将从今年第 3 季度开始略有缓和。IHS Markit 进一步预测认为，汽车芯片供应将在 2022 年第 1 季度全面恢复正常。（国际电子商情）

抢产能！车用芯片转向提前预订晶圆代工产能模式，台积电等代工厂获长约

据 DIGITIMES 报道，台积电、联电、世界先进等晶圆代工厂已与英飞凌多家车用芯片厂签订协议，订单定于 2022 年和 2023 年完成。消息人士称，由于之前缺芯情况严重，车用芯片厂商转变晶圆代工下单模式，由“及时生产”模式转为提前预订产能。（爱集微）

商汤科技自动驾驶 AR 小巴首次亮相 适用于园区通勤、景区观光等场景

商汤科技首次对外介绍 SenseAuto 自动驾驶 AR 小巴。商汤的 SenseAuto 智能汽车解决方案不仅可为智能驾驶提供道路全场景感知方案，还能为智能车舱打造便捷、安全、个性化的智能服务，商汤 AR 小巴在行驶过程中，

也会在屏幕中展讯实景。(闪信息)

广汽今年将量产超级快充技术

广汽集团表示,公司 2021 年将布局超过 100 个超级快充站。2021 年 9 月份将量产超级快充技术,率先搭载在 AIONV 上,分别推出充电倍率分别为 3C500km 和 6C500km 的车型版本,充电桩将根据车型推出时间和销售区域进行重点布局。(闪信息)

现代集团将三家内部初创企业剥离为独立公司 重点开发激光雷达等技术

现代汽车集团宣布将三家内部初创公司 Difon、AutoL 和 Datamond 剥离为独立公司。这三家公司计划进军具有适销性和创新性的新业务领域以及汽车相关业务,并与现代汽车集团开展各种业务合作。(盖世汽车)

寒武纪入局自动驾驶芯片: 7nm 制程, 算力超 200TOPS

7 月 8 日,在 WAIC 智能芯片论坛上,科创板 AI 芯片第一股寒武纪创始人、CEO 陈天石首次回应了业界对寒武纪入局车载智能芯片的猜想,并披露了寒武纪车载智能芯片的关键数据。这款芯片定位于“高等级智能驾驶芯片”,采用 7nm 制程,单芯片算力超过 200 TOPS,符合车规级标准,也支持寒武纪成熟的 AI 软件工具链。(盖世汽车)

4、面板/LED/PCB 等

TCL 华星印度工厂第四季度正式启动生产

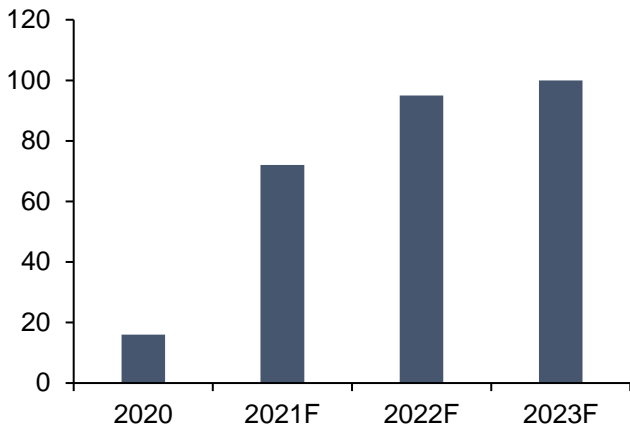
近日,TCL 集团位于印度安得拉邦蒂鲁帕蒂的面板工厂此前受疫情影响暂缓运营,目前已确认将在今年第四季度启动生产。据印度媒体 ET Telecom 报道,TCL 印度总经理 Mike Chen 表示,该公司在 2019 年 9 月宣布投资 15.3 亿元(约 2.19 亿美元),用于在印度制造显示模块。(闪信息)

三星、台积电产能吃紧 OLED 芯片恐现缺货潮

市场估计,OLED 面板的困境尚未解除,未来 OLED 芯片可能会出现缺货潮。moneydj 援引金融时报报道指出,OLED 芯片短缺的迹象即将浮现,第二季度 OLED 芯片的价格已上涨五分之一,各大公司正大举囤货。由于 OLED 芯片毛利低,三星和台积电不会优先生产这部分芯片,而是将焦点放在订单量大的高端芯片上。(爱集微)

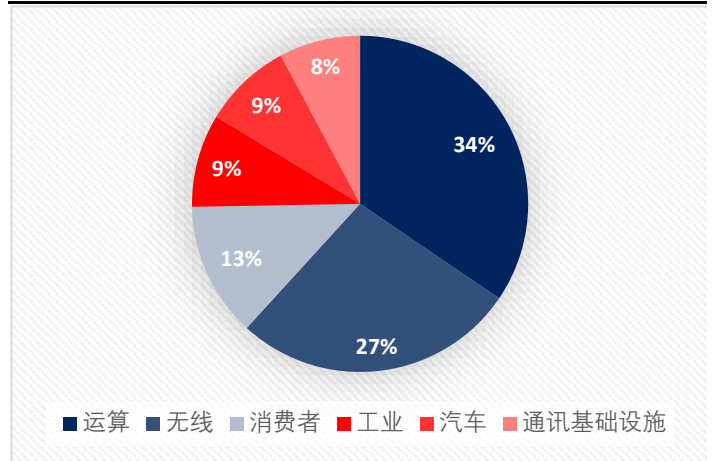
附录三：近期行业数据整理更新

图 4：48 吋 OLED 电视销量展望（万台）



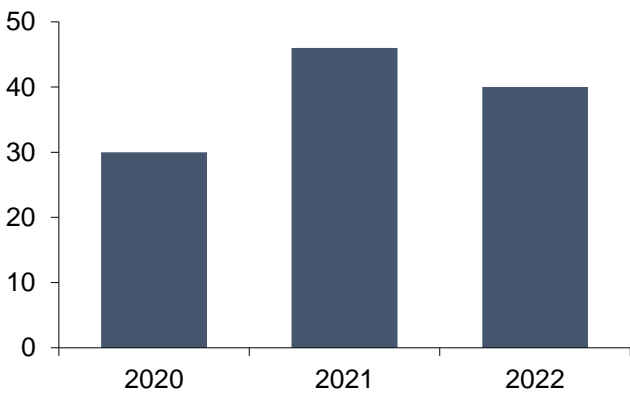
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 5：2020 年全球半导体对应下游市场销售额（亿美元）



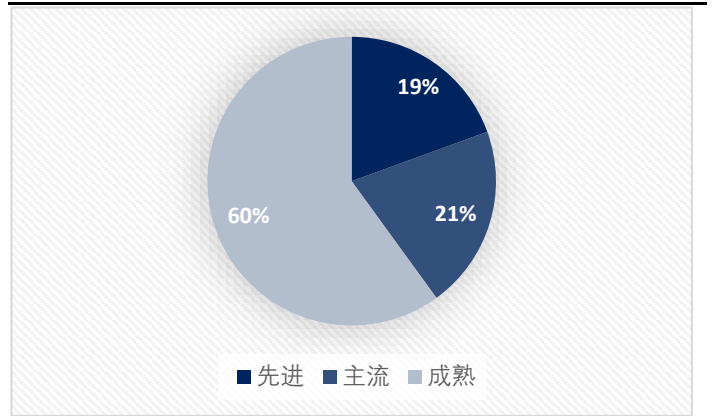
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 6：全球 8 吋晶圆厂设备资本支出与预估（亿美元）



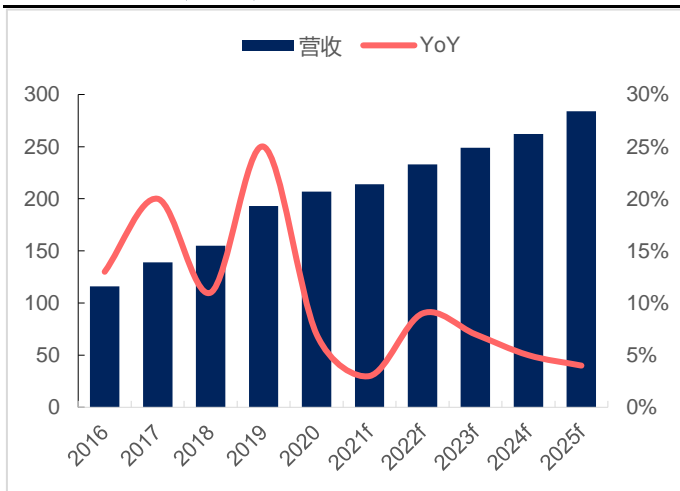
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 7：全球先进、主流、成熟制程已装机晶圆产能比重



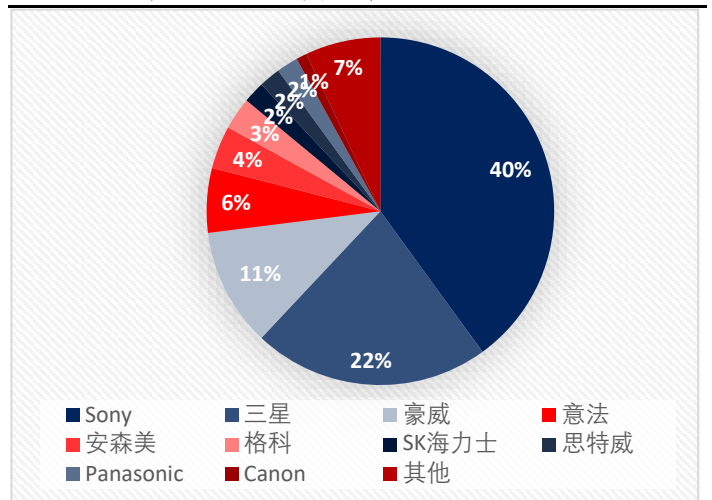
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 8：全球 CIS 市场规模及增速（亿美元）



资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 9：2020 年全球 CIS 厂商市占率



资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

附录四：上市公司重要公告和未来大事提醒

【韦尔股份】前次减持公告披露后至 2021 年 7 月 8 日，虞仁荣先生及其一致行动人虞小荣先生通过上海证券交易所交易系统合计减持韦尔转债 244 万张，占发行总量的 10%。

【瑞芯微】2021 年上半年，公司实现营业总收入 13.78 亿元，同比增长 104.42%；实现利润总额 2.83 亿元，同比增长 203.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.64 亿元，同比增长 184.12%；基本每股收益 0.63 元，同比增长 173.91%。

【兆易创新】公司拟向激励对象授予权益总计 566.57 万股，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 66431.5107 万股的 0.85%。

【中微公司】2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，限制性股票拟归属数量 152.1436 万股；归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

【立讯精密】因实施公司 2020 年年度权益分派，公司可转换公司债券于 2021 年 6 月 28 日起暂停转股，2021 年 7 月 8 日起恢复转股。

【深天马 A】2021 年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润 11.6-13 亿元，比上年同期增长 55.83%-74.63%。

【中颖电子】2021 年上半年归属于上市公司股东的净利润预计 1.49—1.55 亿元，同比增长 58%-65%；扣除非经常性损益后的净利润 1.39—1.45 亿元，同比增长 67%-75%。

【精测电子】公司控股股东、实际控制人彭骞先生于 2021 年 7 月 5 日质押 8,500,000 股公司股份，占其持有股份的 12.12%，占公司总股份数的 3.06%。

【北京君正】2021 年 7 月 6 日，公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。本次非公开发行拟募集 14.07 亿元，用于嵌入式 MPU 系列芯片的研发与产业化、智能视频系列芯片的研发与产业化、车载 LED 照明系列芯片的研发与产业化、车载 ISP 系列芯片的研发与产业化项目。

【胜宏科技】2021 年 7 月 6 日，公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。本次非公开发行拟募集 20.00 亿元，用于高端多层、高阶 HDI 印制线路板及 IC 封装基板建设项目。

【士兰微】士兰微将通过发行股份的方式收购国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的集华投资 19.51% 股权、士兰集昕 20.38% 股权，并募集 11.22 亿元，用于 8 英寸集成电路芯片生产线二期项目。拟发行股份数 82,350,000，占发行前公司总股本的 0.628%。

【大华股份】计划非公开发行股票，调整后的发行价格为 17.67 元/股，募集资金总额不超过 51 亿元，用于智慧物联解决方案研发及产业化项目等项目的建设。

【韦尔股份】公司现拟以现金方式由香港韦尔收购斐泉华创持有的标的公司 30% 的股权。收购涉及关联交易，定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

【汇顶科技】自本次回购实施开始至 2021 年 6 月 30 日，公司股份回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已回购公司股份数量为 333.27 万股，占公司总股本的比例为 0.73%，购买的最高价为 124.69 元/股，最低价为 114.35 元/股，已支付的总金额为 4.01 亿元（不含交易费用）。

【闻泰科技】2021 年 7 月 5 日，公司全资子公司 Nexperia B.V. 与 NEPTUNE 6 LIMITED 及其股东签署了有关收购协议。本次交易完成后，公司将间接持有 Newport Wafer Fab 100% 权益。

研究团队简介

方竞，西安电子科技大学本硕连读，近5年半导体行业从业经验，有德州仪器等外企工作经历，熟悉半导体及消费电子产业链。同时还是国内知名半导体创业孵化平台IC咖啡的发起人，曾协助多家半导体公司早期融资。2017年在太平洋证券，2018年在招商证券，2020年加入信达证券，任电子行业首席分析师。所在团队曾获19年新财富电子行业第3名；18/19年《水晶球》电子行业第2/3名；18/19年《金牛奖》电子行业第3/2名。

李少青，武汉大学硕士，2018年加入西南证券，2020年加入信达证券，主要覆盖晶圆厂、数字芯片及射频，同时兼顾面板及智能机。

刘志来，上海社会科学院金融硕士，2020年加入信达证券，覆盖VRAR，光学，存储器板块。

童秋涛，复旦大学资产评估硕士，2020年加入信达证券，产能为王，覆盖功率、模拟、封测板块。

机构销售联系人

区域	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	韩秋月	13911026534	hanqiyue@cindasc.com
华北区销售副总监(主持工作)	陈明真	15601850398	chenmingzhen@cindasc.com
华北区销售	卞双	13520816991	bianshuang@cindasc.com
华北区销售	阙嘉程	18506960410	quejiacheng@cindasc.com
华北区销售	刘晨旭	13816799047	liuchenxu@cindasc.com
华北区销售	欧亚菲	18618428080	ouyafei@cindasc.com
华北区销售	祁丽媛	13051504933	qiliyuan@cindasc.com
华北区销售	魏冲	18340820155	weichong@cindasc.com
华北区销售	陆禹舟	17687659919	luyuzhou@cindasc.com
华东区销售副总监(主持工作)	杨兴	13718803208	yangxing@cindasc.com
华东区销售	吴国	15800476582	wuguo@cindasc.com
华东区销售	国鹏程	15618358383	guopengcheng@cindasc.com
华东区销售	李若琳	13122616887	liruolin@cindasc.com
华东区销售	张琼玉	13023188237	zhangqiongyu@cindasc.com
华南区销售总监	王留阳	13530830620	wangliuyang@cindasc.com
华南区销售	陈晨	15986679987	chenchen3@cindasc.com
华南区销售	王雨霏	17727821880	wangyufei@cindasc.com
华南区销售	王之明	15999555916	wangzhiming@cindasc.com
华南区销售	闫娜	13229465369	yanna@cindasc.com
华南区销售	焦扬	13032111629	jiaoyang@cindasc.com

分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

免责声明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

评级说明

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数：沪深 300 指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起 6 个月内。	买入 ：股价相对强于基准 20% 以上；	看好 ：行业指数超越基准；
	增持 ：股价相对强于基准 5%~20%；	中性 ：行业指数与基准基本持平；
	持有 ：股价相对基准波动在±5% 之间；	看淡 ：行业指数弱于基准。
	卖出 ：股价相对弱于基准 5% 以下。	

风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。